OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DAM-MATERIAALIT

LOCTITE® FP4451TD™
COB Dam

- COB Dam
- Kapselointimateriaali
- LOCTITE®

TUOTEKUVAUS

Henkel LOCTITE ECCOBOND FP4451TD on epoksipohjainen DAM-materiaali elektroniikan Dam & Fill -kapselointiin. Materiaalilla muodostetaan kapseloitavan alueen ympärille tarkkarajainen reuna, joka estää myöhemmin annosteltavaa Fill-materiaalia leviämästä halutun alueen ulkopuolelle.

Hyvän muodonpitävyyden ansiosta materiaalilla voidaan muodostaa korkea ja kapea rajaus, mikä helpottaa kapselointikerroksen korkeuden ja muodon hallintaa. Se soveltuu erityisesti paljaiden puolijohdesirujen, lankabondattujen komponenttien, BGA-rakenteiden ja IC-muistipiirien kapselointiin.

Lämpökovetteinen epoksimateriaali tarjoaa hyvän kemikaalinkestävyyden ja lämpöstabiilisuuden. Käyttölämpötila-alue on -65…+150 °C ja lasittumislämpötila (Tg) noin 150 °C. Suuri puhtaus tukee käyttöä vaativissa elektroniikka- ja puolijohdesovelluksissa.

Dam & Fill -menetelmä soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa kapselointialueen rajat ja pinnan korkeus halutaan hallita tarkasti. DAM-materiaali muodostaa ensin rajauksen, jonka sisäpuolelle varsinainen matalaviskoosisempi Fill-kapselointimateriaali annostellaan suojaamaan komponenttia ja herkkiä liitoksia.